

2025년 6월 30일 제45호

연구위원 황규완
연구위원 서유나
연구위원 이예린

HIF 월간 산업 이슈(6월)

Monthly Industrial Issue

산업별 주요 이슈

철강 **철강업 침체 장기화되는 가운데, 공정별 실적은 차별화**

- 확대되는 대내외 리스크로 철강업 침체가 지속되는 가운데, 구조적 요인으로 공정별 영향은 상이하게 나타나며 '25년 1분기 상공정 업체를 중심으로 매출이 크게 축소
- 하반기 상공정 부문 실적 개선에 대한 기대 요인도 존재하나, 지속되는 시장 불확실성으로 실적 회복이 지연되고 하공정 부문의 수익성 저하 압력도 높아질 전망

반도체 **유리기판, 차세대 반도체 패키징 경쟁의 주인공**

- 최근 삼성전자의 유리기판 로드맵이 확인되면서 기존 실리콘, 유기 소재 대비 열·전기적 특성이 뛰어나며 고밀도 회로 구현이 가능한 유리기판에 대한 관심이 주목
- 인텔, 삼성전기, SKC 등 주요 기업들은 유리기판 상용화 기술 확보를 위해 노력 중이며 고성능 반도체 수요 증가에 따라 '28년 이후 유리기판 시장이 본격 성장할 전망

건설 **2차 추경에 따른 건설업 업황 전망**

- 2차 추경 중 건설경기 활성화를 위한 추가 예산은 2.7조원이며 민간 자금과 매칭될 경우 최대 5조원 이상의 유동성이 건설업계에 공급될 수 있을 전망
- 다만, 부동산 시장의 양극화가 심해 민간 자금의 매칭이 쉽지 않고 금융규제 강화 등을 고려할 때 단기간 회복도 어려워 추경의 효과는 제한적일 것으로 예상

산업 이슈

철강

철강업 침체 장기화되는 가운데, 공정별 실적은 차별화

반도체

유리기판, 차세대 반도체 패키징 경쟁의 주인공

건설업

2차 추경에 따른 건설업 업황 전망

C24. 철강

철강업 침체 장기화되는 가운데, 공정별 실적은 차별화

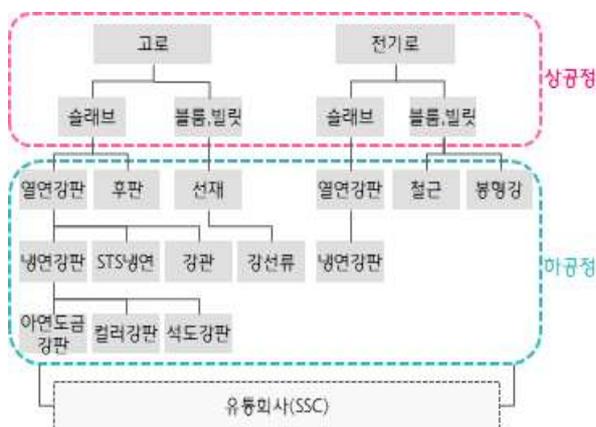
연구원 이예린

※ Summary : 내수 수요 부진과 미국의 관세 강화 조치로 대내외 리스크가 확대되며 철강업 침체가 장기화되는 가운데, 구조적 요인으로 공정별 영향은 상이. 고정비 부담이 큰 상공정은 지속되는 중국발 공급 과잉과 글로벌 시장 환경 변화 대응을 위한 대규모 투자 등으로 실적이 악화. 하공정은 수입 철강재 유입으로 수익성이 악화되었으나, 품목별 차별화된 흐름이 실적 변동폭을 완화. 하반기 상공정 실적 개선에 대한 기대감도 존재하나, 지속되는 시장 불확실성으로 실적 회복이 지연되고 있어 하공정 부문의 수익성 저하 압력은 높아질 전망

■ 대내외 리스크 확대로 철강업 침체 장기화되나, 구조적 요인으로 공정별 영향은 상이

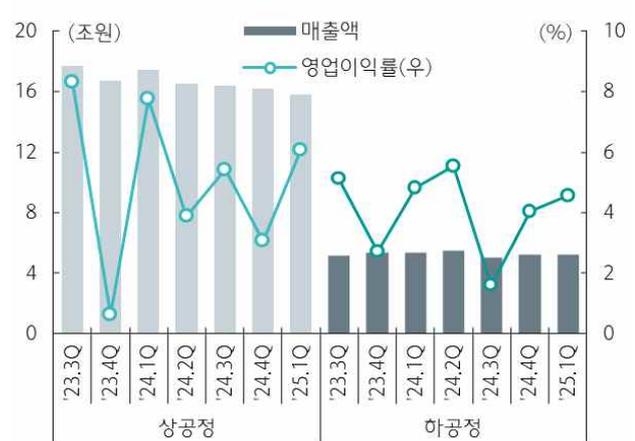
- 국내 철강 수요 회복이 지연되는 상황 속에서, 미국이 철강 수입품에 대한 관세를 50%로 인상하는 등 대외 리스크 요인이 확대되며 국내 철강업의 침체가 장기화
 - 철강업 가동률지수(2020=100) : 105.2('22.1Q) → 96.9('23.1Q) → 98.2('24.1Q) → 90.3('25.1Q)
- 국내 철강 산업 공급망은 생산 공정에 따라 상공정, 하공정, 유통 부문으로 구분될 수 있으며 업황 부진의 원인에 따라 공정 및 제품별 영향은 상이
 - 상공정은 고로나 전기로를 통해 반제품을 만드는 공정으로 소수의 대기업이 주도하고 있으며, 하공정은 반제품에 가공과정을 거쳐 최종 철강재를 생산하는 공정으로 제품별로 업체가 세분화
- '25년 1분기 상공정 업체를 중심으로 매출이 크게 축소되며 1차 철강 제조업 59개사의 합산매출액은 전년동기대비 7.5% 감소하고 영업이익률은 1.4%p 하락

그림1 | 국내 철강산업 생태계



자료 : 하나금융연구소

그림2 | 공정별 업체 실적 비교



주 : 상공정 9개사, 하공정 40개사 합산 기준
자료 : Value Search

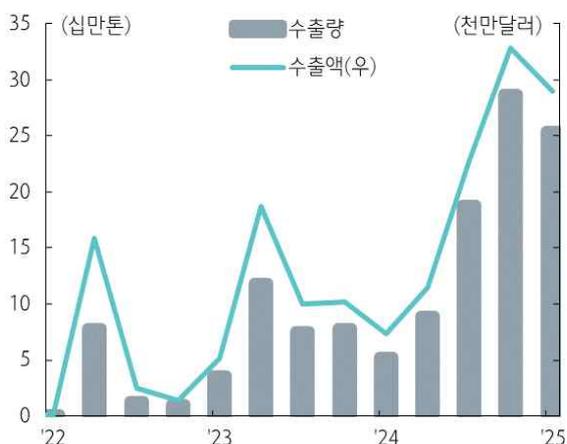
■ 구조적으로 고정비 부담이 큰 상공정은 글로벌 시장 환경 변화로 실적이 악화

- 국내 조강 생산의 72.2%를 차지하고 있는 고로는 수요에 맞춘 탄력적인 생산량 조절이 어렵고 노후 설비의 폐쇄나 이전도 쉽지 않아 상공정 기업들의 고정비 부담이 확대
 - 포스코 조강 가동률(%) : 87.4('22.1Q)→84.7('23.1Q)→85.6('24.1Q)→88.1('25.1Q)
 - '25.1Q 포스코 등 상공정 9개사의 합산매출액은 전년동기비 9.3% 감소, 영업이익률은 1.7%p 하락
- 저가 밀어내기 수출을 지속하는 중국이 글로벌 무역장벽에 대응하기 위해 무역 규제가 적은 반제품 형태로 수출을 확대하고 있어 반제품 수출 단가 하락세가 지속
 - 韓반제품 평균수출단가(천USD) : 893('22.1Q)→1,086('23.1Q)→616('24.1Q)→503('25.1Q)
- 환경 규제 및 관세 정책 강화 등 글로벌 시장 환경 변화 대응을 위한 고부가 철강재 개발과 생산기지 해외 이전 등 대규모 투자 필요성이 대두되며 재무 부담이 가중
 - '24년 현대제철 매출액은 전년대비 10.4% 감소했으나, CAPEX 비용은 103% 증가
- 하공정 업체는 수입산 철강재 유입 증가에 따른 가격 하락세로 수익성이 악화되었으나, 전방 산업 업황에 따라 품목별 차별화된 흐름이 하공정 부문 실적 변동폭을 완화

■ 하반기에도 상공정 실적 부진 지속되는 가운데, 하공정 수익성 압박이 확대

- 하반기 내 중국발 리스크가 해소되지 않고 해외 시장의 불확실성이 확대되며 상공정 업체의 실적 회복이 지연될 것으로 예상되나, 하반기 본격화되는 후판 반덤핑 관세 효과와 열연 반덤핑 제소 등 상공정 업체의 롤마진 개선에 대한 기대요인도 존재
 - 열연의 경우 반덤핑 대상국에 일본도 포함되며 후판보다 반덤핑 효과가 클 것으로 예상
- 하공정 부문은 美철강 관세 조치로 양호했던 강관 제조업체의 수익성 하락이 우려되고 건설업 침체로 철근, 형강 등 열간 압연 제품 업체들의 실적 부진도 지속될 전망 📉

그림3 | 중국 반제품 수출량 및 수출액 추이



자료 : TradeMap

그림4 | 품목별 출하량 추이



주 : 1~4월 누적 기준
자료 : 한국철강협회

C26. 반도체

유리기판, 차세대 반도체 패키징 경쟁의 주인공

연구원 서유나

※ Summary : 최근 삼성전자가 반도체 패키징에 글라스 인터포저 기술을 도입하려는 움직임이 확인되면서 유리기판에 대한 관심이 주목. 유리기판은 인터포저 또는 메인기판을 유리로 대체하는 기술을 의미하는데 기존 실리콘, 유기 소재 대비 열·전기적 특성이 뛰어나며 고밀도 회로 구현이 가능해 차세대 반도체 패키징 핵심 소재로 부각. 인텔을 비롯해 삼성전기, SKC 등 글로벌 반도체 기업들은 유리기판 상용화 기술 확보에 속도를 내는 중. AI 가속기 및 HPC 등 고성능 반도체 수요가 증가함에 따라 '28년 이후 유리기판 시장이 본격 성장할 전망

■ 최근 삼성전자의 유리기판 로드맵이 확인되면서 유리기판에 대한 관심이 주목

- 지난 5월 말, 삼성전자는 '28년부터 고성능 AI 반도체 패키징에 실리콘 인터포저¹⁾ 대신 글라스 인터포저를 활용하겠다는 전략을 수립
 - 올해 삼성전기와 협력해 천안 패키징 센터에서 공정 검증을 진행할 예정이며, '27년 글라스 인터포저를 적용한 양산을 시작으로 '28년까지 상용화하겠다는 계획
- 유리기판은 인터포저 또는 메인기판을 유리로 대체하는 기술을 의미하는데 기존 실리콘, 유기 소재보다 표면 평탄도가 뛰어나고 미세 패터닝이 가능해 차세대 패키징 소재로 주목
 - 최종 지향점은 글라스 코어 기판이나 삼성전자의 경우 우선적으로 글라스 인터포저 도입을 추진
- 또한 열 변형, 휨(Warping) 현상에 강하고 신호 손실을 적어 데이터 처리 속도 및 전력 효율을 높일 수 있어 AI 반도체의 고질적 문제인 발열, 전력 소모 해결이 가능

그림 5 | 글로벌 유리기판 시장 규모 전망



자료 : The Business Research Company

표 1 | 유리기판 구조 및 특징

구분	글라스 인터포저 (Glass Interposer)	글라스 코어 기판 (Glass Core Substrate)
구조		
위치	칩과 기판 사이	패키지 하단(기판)
특징	<ul style="list-style-type: none"> 실리콘, 유기 인터포저를 글라스 인터포저로 대체 고가의 실리콘 인터포저만을 유리로 대체하는 방식이 우선 도입 	<ul style="list-style-type: none"> 패키지 기판의 코어층을 유리로 제작해 별도의 인터포저가 필요 없음 MLCC 등 수동부품을 코어층 안에 탑재 가능
업체	TSMC, 삼성전자 등	삼성전기, SKC, LCI노텍 등

자료 : LPKF, 언론보도 종합

1) 인터포저(Interposer): 반도체 집적회로(로직, 메모리 등)와 기판(substrate) 사이에 위치해 물리적·전기적으로 연결해주는 중간 부품

■ 국내외 주요 기업들은 유리기판 상용화 기술 확보에 속도를 내는 중

- 선도주자인 인텔은 '23년 애리조나 공장에 10억 달러를 투자해 유리기판 R&D 라인을 구축했으며 '30년까지 차세대 데이터센터 및 서버 패키지에 유리기판을 적용할 계획
- 삼성전기는 LPFK(獨), 캄트로닉스(韓) 등과 기술 협약을 체결하며 유리기판 제조를 위한 장비를 공동 개발 중에 있으며, 올해 시제품 생산을 시작할 예정
- SKC는 어플라이드머티리얼즈(美)와 합작해 자회사 애플릭스를 설립하고 美 CHIPS Act 보조금을 받아 조지아주에 세계 최초의 유리기판 양산 공장을 준공
 - 현재 AMD, 아마존 등과 퀄테스트를 진행 중이며 '27년에 대량 생산 전환 예정

■ 유리기판 시장은 고성능 반도체 수요 확대에 따라 빠르게 성장할 전망

- AMD, 브로드컴, 엔비디아 등 글로벌 빅테크들도 생산 비용 절감, 성능 향상 등을 위해 유리기판을 선제적으로 도입하려는 움직임이 보이고 있어 시장 확대가 기대
 - 글로벌 유리기판 시장은 연간 6.6%씩 성장해 '29년 약 108.5억 달러에 달할 전망(TBRC)
- 글라스 인터포저 기술이 우선 도입될 예정이며 향후 글라스 코어 기판 기술 발전에 따라 AI, 고성능컴퓨터(HPC), 통신용 반도체 등에 채택이 본격화될 것으로 예상
- 다만 유리 특성상 깨짐 등 파손 가능성이 크고 제작이 어려워 생산 수율 확보가 과제로 남아 있기 때문에 최소 2~3년은 인프라 및 공정 안정화의 과도적 시기로 판단
- 장기적으로는 반도체의 고집적 및 고성능을 구현할 패키징 소재로 자리 잡을 가능성이 높으며, 공정 경쟁력 확보 여하가 국내 반도체 기업들의 향후 수익성에 직격될 전망 

표2 | 주요 기업의 유리기판 기술개발 동향

밸류체인	기업명	내용	현황	상용화 목표
IDM (종합반도체 업체)	삼성전자(韓)	● 삼성전기 등과 협력해 칩 크기에 맞춘 ‘유닛’ 사이즈의 유리에서 공정을 진행하여 기술 구현 및 시제품 생산 속도를 가속화	연구개발	'28년
	인텔(美)	● '30년 단일 패키지 내 1조 개의 트랜지스터 집적을 목표로 이를 구현할 수 있는 글라스 코어 기판 개발을 주도	파일럿 구축	~'30년
팹리스	AMD(美)	● 작년 말 글라스 코어 기판 관련 특허를 취득하고 글로벌 부품사들과 공급망을 구축 중이며 '25~'26년에 고성능 GPU 등에 도입할 계획	샘플 테스트	'28년
소재·부품	삼성전기(韓)	● 세종 사업장에 유리기판 파일럿 라인을 구축했으며 올해 미국 빅테크 등 다수 고객사에 시제품을 공급할 계획	파일럿 구축	'27년
	SKC(韓)	● 현재 월 5,000장 규모의 생산능력을 고객사들의 퀄테스트 통과 후 단기적으로 2만장, 최대 5만장까지 확대할 계획	샘플 공급	'27년
	LG이노텍(韓)	● 지난해 유리기판 사업을 공식화한 뒤 올해 말 시생산을 시작할 계획	파일럿 구축	'27~'28년
	DNP(日)	● '23년 패키지용 글라스 코어 기판을 개발했으며 '27년 대량 양산을 목표	연구개발	'27년

자료 : 언론보도 종합

F41. 건설업

2차 추경에 따른 건설업 업황 전망

연구위원 황규완

※ Summary : 새정부는 30.5조원의 2차 추경 안을 확정했으며 이 중 건설경기 활성화에 할당된 예산은 2.7조원 수준으로 민간 자금과 매칭할 경우 최대 5조원 이상의 유동성 공급이 가능할 것으로 기대. 지방 중소건설업체 유동성 지원이 근본적인 목적이나 서울 주택시장을 제외하면 지방 및 비주택 부동산 시장은 침체상태에 있어 민간 자금의 매칭이 쉽지 않을 것으로 우려. 전국적인 부동산시장 회복을 기대하기는 어려워 2차 추경의 실질적인 효과는 한계 건설사 구조조정에 따른 지역경제 충격을 완화하는 수준으로 제한될 것으로 예상됨

■ 새정부는 건설경기 활성화를 위해 2차 추경에서 총 2.7조원의 추가 예산을 배정

- 종합건설업체 폐업 수는 2022년 이후 급증하고 있으며 같은 기간, 건설업체의 핵심 수익원인 아파트 분양 역시 과거 대비 30% 이상 급감하는 등 침체가 장기화
 - 공사 수주액에서 주택이 차지하는 비중은 약 40% 내외로 가장 크며 비주택 건축, 설비설치 순
- 새정부는 2차 추경에서 건설경기 활성화를 위해 2.7조원의 추가예산을 배정했으며 민간 자금과 매칭될 경우 전체 자금 지원 규모는 5조원 이상으로 확대될 수 있음
 - 특히 PF 지원은 추경을 통한 정부지원을 마중물로 활용하여 민간 자본을 유인하도록 계획
- 지연된 지방 개발프로젝트의 자금조달 지원(PF 특별보증), 지방에 집중된 미분양의 해소(미분양 안심환매), 지방 SOC 확충 및 소규모 공사 지원 등 지방 중소 건설업체 유동성 지원이 골자

그림6 | 종합건설업체 폐업 수 및 아파트 분양물량



자료 : 국토교통부, 부동산114

표3 | 정부의 2차 추경 중 건설경기 활성화 부문 지출 항목

구 분	지 출 항 목	배 정 금 액
PF 지원 (0.8조원)	(초기) 마중물 리츠	0.3조원
	(착공) PF 특별보증	0.2조원
	(분양) 미분양 안심환매	0.3조원
SOC 투자 (1.4조원)	국가기간망(철도, 도로) 준공 지원	0.7조원
	SOC 안전투자 강화	0.2조원
	재해 예방	0.3조원
국공립시설 (0.5조원)	공공청사 등 국공립시설 소요	0.5조원

자료 : 한국무역협회

■ 중소 건설업체에 유동성 지원이 목적이거나 부동산 양극화로 효과는 제한적일 전망

- PF 지원은 민간 자본이 매칭이 핵심이나 서울 주택시장을 제외하면 부동산 경기가 여전히 침체상태에 놓여 민간 투자자의 외면을 받을 가능성이 높아 실효성이 낮을 것으로 우려
 - 주택 매매가격은 서울(1.4%)만이 전년말 대비 상승했으며 지방광역시는 1.0% 하락
- 지방은 지역 핵심 산업이 경제 불확실성으로 위축되고 있으며 지역소멸이라는 문제점도 안고 있어 지역경제 전반이 회복되지 않는 한 건설경기 회복을 기대하기 어려운 실정
 - 부산은 2024년 소멸위험단계에 진입했으며 나머지 5개 광역시는 모두 소멸주의단계
- 다만, SOC 예산 증액으로 공사비 상승 등으로 지연되던 지방 인프라 건축이 재개될 수 있어 추경의 효과는 지방 중소 건설사 구조조정에 따른 충격을 완화하는 제한적 효과에 그칠 듯

■ 단, 새정부의 공약실현 정도에 따라 건설업황은 점진적으로 개선될 것으로 기대

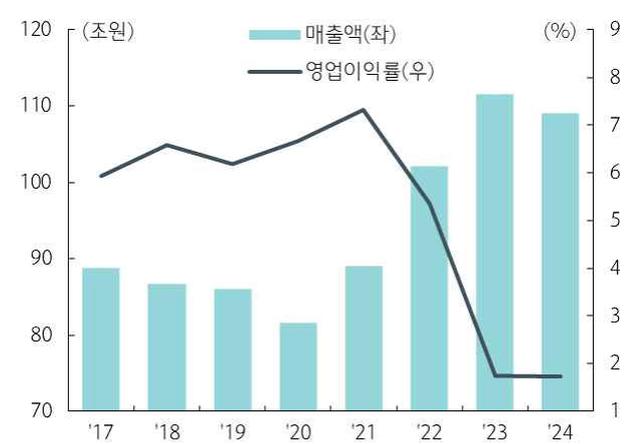
- 금리하락이 예상되나 DSR 강화 및 가격상승 기대감 저하 등으로 전국적인 부동산시장 회복은 더딜 것으로 우려되어 건설업체의 경영실적 역시 단기간 내 개선은 어려울 전망
 - 기 착공 아파트 준공 등으로 매출은 정체, 저가 수주 해소로 영업이익률은 소폭 개선이 기대
- AI 성장을 위한 인프라 확충, 에너지 고속도로 구축, 제조업 경쟁력 제고 등 새정부 공약은 대부분 건설 발주 확대로 이어지므로 공약 실천 여부에 주목할 필요가 있음
 - 데이터센터 개발(비주택 건축), 발전 인프라 및 제조업 생산설비 신축(설비설치)등과 연계
- 단, 국내 GDP에서 건설투자가 차지하는 비중(14% 내외)이 OECD 평균(10% 내외)보다 높아 중장기 건설투자 위축 및 한계 건설사의 구조조정과 건설업 침체는 장기화될 가능성이 높다고 판단⁹⁾

그림7 | 주택 매매가격 변동률 및 미분양 주택 현황



자료 : 국토교통부, 한국부동산원

그림8 | 주요 건설업체 경영 실적



주 : 2024년 기준 시공능력평가 상위 50개 업체 중 41개 업체 합산 실적
자료 : 국토교통부, Value-Search

HIF 월간 산업 이슈
Monthly Industrial Issue.

 **하나은행** 하나금융연구소

04538 서울특별시 중구 을지로 66
(을지로 2가, 하나금융그룹 명동사옥 8층)
TEL 02.2002.2200
E-MAIL hanaif@hanafn.com
<http://www.hanaif.re.kr>